

課題番号 : F-13-FA-0009
利用形態 : 機器利用
利用課題名 (日本語) : マイクロはんだバンプの形成
Program Title (English) : The formation of the microsolder Bump
利用者名 (日本語) : 西 弘敏
Username (English) : Hirotooshi Nishi
所属名 (日本語) : 株式会社新菱
Affiliation (English) : Shinryo Corporation

1. 概要 (Summary)

本課題では、微細化が望まれるフリップチップ実装向けのバンプ形成について、検討を行うものである。めっき技術の検討に加え、めっきの前後工程に当たるレジスト加工、レジスト剥離、エッチングについて、共同研究開発センターの機器を利用し、検討を行った。

2. 実験 (Experimental)

バンプ形成に必要なレジスト形成及び剥離処理条件を検討した。

(利用機器)

スピニングコート、ホットプレート、露光機、RIE 等



Mask Aligner

Reactive Ion Etcher

3. 結果と考察 (Results and Discussion)

レジスト加工の処理条件を検討することにより、 ϕ 20 μ m までの微細バンプを形成することができた。

今後、条件の最適化に向け、処理条件のパラメータ振りを実施する。

4. その他・特記事項 (Others)

なし。

5. 論文・学会発表 (Publication/Presentation)

なし。

6. 関連特許 (Patent)

なし。